

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年1月5日(2012.1.5)

【公開番号】特開2011-119548(P2011-119548A)

【公開日】平成23年6月16日(2011.6.16)

【年通号数】公開・登録公報2011-024

【出願番号】特願2009-276906(P2009-276906)

【国際特許分類】

H 01 L 21/301 (2006.01)

C 09 J 7/02 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/78 M

H 01 L 21/78 Q

H 01 L 21/78 B

C 09 J 7/02 Z

【手続補正書】

【提出日】平成23年11月15日(2011.11.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0058

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0058】

<チップ分割率>

上記のステルスダイシング条件で、シリコンウエハの内部に改質部を形成し、ウエハと8インチウエハ用リングフレームとを実施例又は比較例の粘着シートに貼付後、エキスバンド装置(ディスコ社製、DDS2010)を用いて、粘着シートをエキスバンドし、ウエハをチップ化した。なお、カットチップサイズが2mm×2mmのものは、粘着シートをエキスバンド(300mm/分で10mm引き落とし)してウエハをチップ化し、カットチップサイズが0.5mm×0.5mm及び0.15mm×0.15mmのものは、エキスバンド(300mm/分で5mm引き落とし)と同時に粘着シートを基材側から治具を用いてひっかいて、ウエハをチップ化した。カットチップサイズにチップ化されたチップの数(完全に個片化されたチップの数)を目視にて数え、ウエハ上に想定された全チップ数(仮想チップの合計数)に対するチップ分割率を算出した。チップ分割率が99.5%以上の場合を「非常に良好」、98%以上を「良好」、98%未満を「不良」とした。また、粘着シートの粘着剤層にエネルギー線硬化型の粘着剤層を用いる場合は、エネルギー線照射前に粘着シートをエキスバンドした。